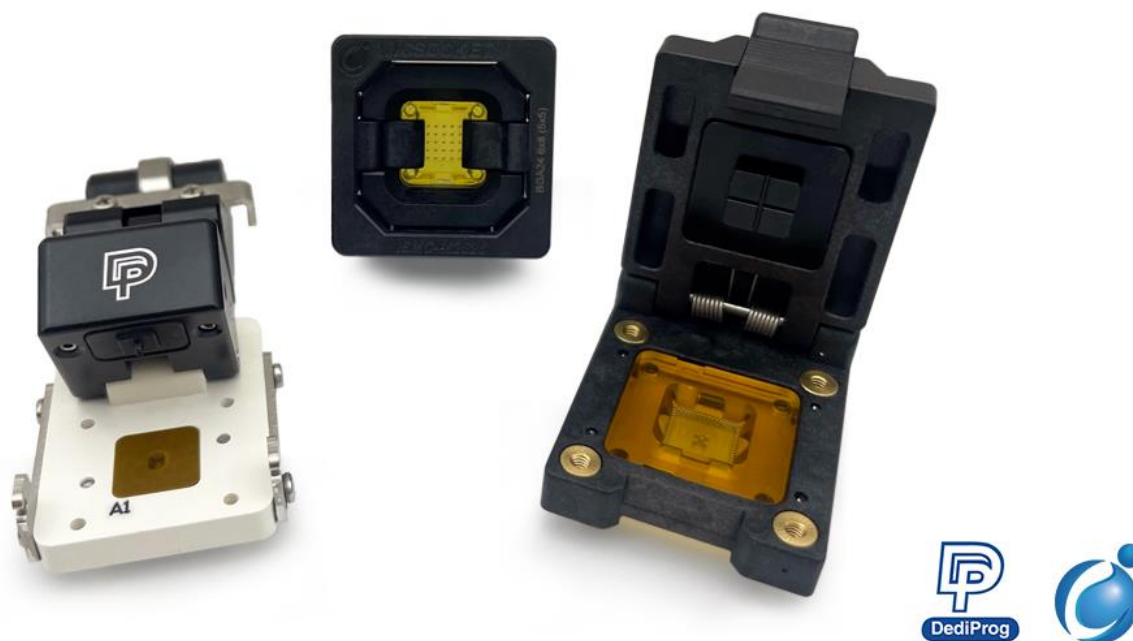


標題：岱鎔搶攻高階半導體測試市佔，啟動上下游整合大計

2022.07.XX / TAIPEI, Taiwan

因應近年全球高階運算晶片設計風起雲湧，半導體預燒測試(Burn-in Test)需求因應大增，IC 晶片燒錄大廠岱鎔科技於 2022 年啟動上下游整合大計，將半導體測試座廠艾沙奇股份有限公司納為百分百全資子公司，以艾沙奇旗下品牌「ICSOCKET」與精實技術力全力衝刺半導體預燒測試與燒錄市佔。

經歷疫情後的缺貨潮，岱鎔科技創辦人暨總經理曹忠勇坦言，台灣所具最重要優勢就是多年累積的半導體製程、設備材料與人才的強勁完整產業鏈，看好「ICSOCKET」為公司業績帶來的加乘效應，尤其在高階半導體產能供不應求的近三年，客戶若能完善整合供應商體系，將能減輕交期的風險與成本。有鑒於客戶端發聲，岱鎔整合旗下資源並提供一條龍的晶片測試與燒錄服務，包含母品牌 DediProg 旗下的設備銷售、研發與技術支援，以及子品牌 ICSOCKET 半導體測試與燒錄座開發，滿足高階半導體客戶製程之需求。



然而半導體預燒製程為什麼日益重要？值得注意的是，晶片愈小愈精密化，運算過程中將產生更多熱能讓晶片溫度提升，影響成品的穩定度與可靠性，執行預燒測試則可確保晶片的良率，因此該步驟已成關鍵的半導體後段製程之一。「ICSOCKET」研發之開蓋式測試座(Open Top)、掀蓋式測試座(Clamshell)與針對 WLCSP 晶片開發的 DISO 燒錄座，經過精密的 CAE 計算與分析，可大幅提升產品的物理性能與穩定度，開蓋式測試座(Open Top)主力為晶片燒錄客群，掀蓋式測試座(Clamshell)則專屬 IC 測試客群，而 DISO 燒錄座則在「極小晶片」燒錄良率表

現更佳，除了支援廣泛的晶片規格，精密夾式結構與彈簧探針（Pogo Pin）設計可支援微型晶片 0.8x0.8mm 燒錄測試，最大程度地減少 WLCSP 晶片所承受的機械應力，降低晶片在測試過程中的裂損風險，也因此 DISO 燒錄座以高於業界基準五倍的使用壽命取得多國專利。

岱鐸曹總經理信心的表示，由於 ICSOCKET 在產品開發初期即設定以提升產品的相容度為基準，因此工程團隊能運用旗下產品進行多種類的產品驗證，進而大幅地提升晶片預燒測試及燒錄良率。岱鐸科技(DediProg)成立於 2005 年，以精實卓越的研發團隊及布局全球專業通路，成為台灣晶片燒錄技術領導品牌商，岱鐸秉持「落實品質、確實生產、精實研發」原則，為客戶供一站式的晶片測試及燒錄方案。詳細資訊請點擊連結：www.dedipro.com

###

標題：19 字 內文：857 字

發稿公司：岱鐸科技股份有限公司

發稿日期：2022/07/20

聯絡人：張谷語 行銷專員